第十八届中国芯优秀产品征集评选申报表

（封装测试）

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称（中英文） |  |
| 企业简介 |  |
| 联系人姓名 |  | 职务 |  |
| 地址 |  | 邮编 |  |
| 座机电话 |  | 手机 |  |
| E-mail |  | 传真 |  |
| 现有人员学历情况占比 |  |

|  |
| --- |
| 公司市场及销售情况 |
| 企业销售额（万元） | 2023年 |  | 2024年（上半年） |  |
| 企业人员规模 | 2023年 |  | 2024年（上半年） |  |
| 净利润（大致量级）（万元） |  | 近三年企业研发投入占营业收入的比重 |  |
| 融资轮次 |  |
| 公司近两年有无上市意向（如有，请填写下行内容） |  |
| 拟上市地（主板/中小板/创业板/科创板/其他） |  | 上市进程（已改制/辅导中/已受理/其他） |  |
| 现有人员学历情况占比（大专及以下、本科、硕士、博士占比情况） |  |
| 公司产品销售主要依靠 | □公司自有销售团队□委托分销代理商□其他方式 |
| 2023年全年预计市场份额（注：根据市场总量实际估测） |  |
| 申报产品技术与市场情况 |
| 所在领域 | □集成电路封装 | 应用领域（选填项） |  |
| □集成电路测试 |
| 项目简介（500字以内） |  |
| 先进性描述（500字以内） |  |
| 创新性描述（500字以内） |  |
| 产品或技术发明专利和自主知识产权情况 |  |
| 成果物应用情况 （500字以内）   |  |
|

|  |
| --- |
| 法律声明： 申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追究其法律责任的权利。法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |

注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。 |